



## 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年8月14日

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス

上場取引所 東

コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 文 TEL 03-3281-8186

四半期報告書提出予定日 2020年8月14日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無

四半期決算説明会開催の有無： 無

(百万円未満切捨)

### 1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第1四半期	20,526	△2.3	1,560	△25.5	563	△68.5	△1,096	ー
2020年3月期第1四半期	21,002	△7.4	2,094	△22.6	1,789	0.2	1,326	94.1

(注) 包括利益 2021年3月期第1四半期 △2,325百万円 (ー%) 2020年3月期第1四半期 2,444百万円 (ー%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年3月期第1四半期	△29.55	ー
2020年3月期第1四半期	35.83	35.81

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年3月期第1四半期	189,396	48,082	24.1	1,229.84
2020年3月期	190,010	50,147	25.5	1,303.89

(参考) 自己資本 2021年3月期第1四半期 45,646百万円 2020年3月期 48,395百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年3月期	ー	12.00	ー	12.00	24.00
2021年3月期	ー				
2021年3月期 (予想)		12.00	ー	12.00	24.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

### 3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期 (累計)	40,000	△4.4	3,000	△15.9	2,500	1.1	0	△100.0	0.00
通期	85,000	4.1	6,500	8.1	5,500	29.0	1,500	△16.0	40.41

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料 8 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2021年3月期1Q	37,209,702株	2020年3月期	37,209,702株
② 期末自己株式数	2021年3月期1Q	93,568株	2020年3月期	93,568株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年3月期1Q	37,116,134株	2020年3月期1Q	37,037,199株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 3 ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報等)	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における経済状況は、米国経済は、新型コロナウイルス感染症が全米各地で拡大し、2020年4月～6月のGDP速報値では過去最大の落込みとなり、中央銀行は経済対策として追加の金融緩和策を打ち出しております。中国経済は、米中の貿易摩擦の長期化と同新型コロナウイルス感染症の影響から景気減速に至りましたが、感染症の収束後からは景気回復に転じています。我が国では緊急事態宣言解除後も、感染者が拡大しており商業活動等に影響が出ているため、今後の経済見通しは不透明な状況が続くものと考えられます。為替相場は、円高方向で推移いたしました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体メモリや液晶・有機ELパネルなどの設備投資は調整局面が続いておりましたが、リモートワーク等の普及からPCやサーバー用途のメモリ需給バランスが改善し、デバイスメーカーの設備投資再開や設備稼働率は徐々に持ち直しの傾向となりました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、製造装置向けの機能部品販売や受託製造等は回復の兆しがみられ、半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品の販売も前年並みの水準となりました。

電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、北米・中国の自動車販売の減少により温調シート向けが軟調な展開となりましたが、次世代通信システム機器向けを中心に伸長し、バイオやPCR検査装置などの医療機器向けは底堅く推移しました。パワー半導体用基板も堅調に推移しました。

なお、中国子会社において太陽電池用多結晶インゴット製造設備等を賃貸し、受託加工をしておりましたが、契約締結先会社より新型コロナウイルス感染症による業績不振のため契約解除の申し出があったため、契約を解除することといたしました。このため遊休となった同製造設備を減損処理し、特別損失に計上いたしました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は20,526百万円（前年同期比2.3%減）、営業利益は1,560百万円（前年同期比25.5%減）、経常利益は563百万円（前年同期比68.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,096百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益1,326百万円）となりました。

当第1四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

#### (半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンウエーハ加工、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

主力の真空シールは、半導体および有機ELパネルなどの製造装置内に装着され、密封空間を保持する機能部品です。半導体や有機ELパネルメーカーの設備投資は、調整局面から回復の兆しがみられました。また、半導体のウエーハプロセスに使用されるマテリアル製品（石英・セラミックス等）は、各国のロックダウンによるリモートワーク等の拡大により、PCやサーバー用途の各種メモリの価格が回復し、デバイスメーカー各社の設備投資や生産活動が再開されたため、需要は前年並みの水準となりました。シリコンウエーハ加工は、一定の水準で推移しましたが、設備償却費が負担となりました。半導体製造装置、有機ELパネル製造装置などの部品洗浄は、堅調に推移しました。

当該事業は、半導体製造装置の設備投資及び稼働率に連動します。

この結果、当該事業の売上高は13,887百万円（前年同期比0.1%増）、営業利益は736百万円（前年同期比55.7%減）となりました。

#### (電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

主力のサーモモジュールは、自動車温調シート向けが北米および中国市場での自動車販売数の減少により、軟調な展開となりました。5G用の移動通信システム機器、PCR等の医療検査装置向けは計画のとおり推移しました。パワー半導体用DCB基板は、順調に売上を伸しており、車載用のAMB基板は、数多くの顧客において認定取得中であり、年内に量産化を計画しております。磁性流体は、スピーカー向けとスマートフォン用途の需要は一定の水準で推移しました。

当該事業の各製品は、景気に左右されにくい業種への販売を進めております。

この結果、当該事業の売上高は3,467百万円（前年同期比6.4%増）、営業利益は883百万円（前年同期比23.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ613百万円減少し、189,396百万円となりました。これは主に原材料及び貯蔵品729百万円が増加した一方、現金及び預金1,390百万円の減少によるものであります。

<負債>

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ1,452百万円増加し、141,314百万円となりました。これは主に短期借入金2,117百万円が減少した一方、1年内返済予定の長期借入金1,860百万円、その他固定負債1,743百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ2,065百万円減少し、48,082百万円となりました。これは主に非支配株主持分670百万円が増加した一方、利益剰余金1,542百万円、為替換算調整勘定1,277百万円の減少によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、第2四半期連結累計期間は、2020年8月7日に公表の「2021年3月期第2四半期累計連結業績予想の修正に関するお知らせ」から変更ありません。

また、通期業績予想につきましては、2020年6月16日に公表いたしました「2020年3月期決算短信」において、新型コロナウイルス感染症の影響などにより市場動向が不透明であることから、通期の業績予想の開示を見送らせていただきましたが、現時点において、自動車市場の業界動向などについては依然不透明さも残るものの、当社の主力市場となる半導体市場については、ある程度市場動向が見通せる環境になりつつあることから、本日開催の取締役会において通期の業績予想を決定いたしました。

詳細につきましては、本日公表いたしました「通期業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	23,709,139	22,318,514
受取手形及び売掛金	20,435,086	21,263,996
商品及び製品	6,046,893	5,898,143
仕掛品	4,459,132	5,046,249
原材料及び貯蔵品	6,763,152	7,492,362
その他	11,641,000	10,435,543
貸倒引当金	△1,602,762	△1,359,140
流動資産合計	71,451,642	71,095,669
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	27,346,105	26,636,967
機械装置及び運搬具（純額）	30,113,013	27,525,665
工具、器具及び備品（純額）	7,021,774	6,388,834
土地	1,891,733	1,890,358
リース資産（純額）	5,550,558	5,342,637
建設仮勘定	38,893,503	42,798,518
有形固定資産合計	110,816,688	110,582,981
無形固定資産		
のれん	25,521	10,521
その他	474,509	447,187
無形固定資産合計	500,031	457,709
投資その他の資産		
その他	7,288,199	7,532,943
貸倒引当金	△46,506	△272,411
投資その他の資産合計	7,241,692	7,260,531
固定資産合計	118,558,412	118,301,222
資産合計	190,010,054	189,396,891

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	18,251,741	17,903,390
短期借入金	12,510,147	10,392,222
1年内償還予定の社債	3,368,000	3,368,000
1年内返済予定の長期借入金	10,138,630	11,999,582
未払法人税等	586,948	714,166
賞与引当金	1,049,139	867,440
その他	15,538,776	16,153,151
流動負債合計	61,443,383	61,397,954
固定負債		
社債	19,282,000	18,807,000
転換社債型新株予約権付社債	3,734,976	3,734,976
長期借入金	29,439,887	29,677,131
退職給付に係る負債	649,603	641,589
役員退職慰労引当金	11,700	12,600
訴訟損失引当金	65,278	63,779
資産除去債務	139,543	139,790
その他	25,095,901	26,839,628
固定負債合計	78,418,891	79,916,494
負債合計	139,862,275	141,314,449
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,649,285	17,649,285
資本剰余金	18,547,939	18,550,344
利益剰余金	10,831,985	9,289,980
自己株式	△86,644	△86,644
株主資本合計	46,942,566	45,402,966
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	39,094	99,146
為替換算調整勘定	1,548,784	271,275
退職給付に係る調整累計額	△135,239	△126,634
その他の包括利益累計額合計	1,452,638	243,787
新株予約権	73,381	86,330
非支配株主持分	1,679,192	2,349,357
純資産合計	50,147,779	48,082,442
負債純資産合計	190,010,054	189,396,891

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
売上高	21,002,355	20,526,102
売上原価	13,888,298	13,730,882
売上総利益	7,114,057	6,795,219
販売費及び一般管理費	5,019,607	5,234,716
営業利益	2,094,449	1,560,502
営業外収益		
受取利息	11,076	12,545
補助金収入	34,562	159,312
持分法による投資利益	62,354	181,922
その他	74,696	43,801
営業外収益合計	182,690	397,581
営業外費用		
支払利息	262,495	398,408
為替差損	53,570	900,050
その他	171,173	96,425
営業外費用合計	487,240	1,394,884
経常利益	1,789,898	563,200
特別利益		
投資有価証券売却益	42,760	—
特別利益合計	42,760	—
特別損失		
減損損失	—	1,094,138
特別損失合計	—	1,094,138
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,832,659	△530,938
法人税等	543,285	549,634
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,289,373	△1,080,572
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△37,483	16,039
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	1,326,857	△1,096,611



(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,289,373	△1,080,572
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	31,513	57,582
為替換算調整勘定	1,115,380	△1,292,674
退職給付に係る調整額	5,300	5,999
持分法適用会社に対する持分相当額	2,489	△15,565
その他の包括利益合計	1,154,683	△1,244,657
四半期包括利益	2,444,057	△2,325,229
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,464,650	△2,305,463
非支配株主に係る四半期包括利益	△20,593	△19,766

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	13,876,947	3,259,034	17,135,982	3,866,373	21,002,355	—	21,002,355
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	115,905	—	115,905	—	115,905	△115,905	—
計	13,992,853	3,259,034	17,251,887	3,866,373	21,118,260	△115,905	21,002,355
セグメント利益又 は損失(△)	1,665,018	714,096	2,379,115	△121,636	2,257,479	△163,029	2,094,449

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△163,029千円には、セグメント間取引の消去150,237千円、各報告セグメントに配分していない全社費用12,792千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	13,887,964	3,467,903	17,355,868	3,170,233	20,526,102	—	20,526,102
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	10,567	—	10,567	174,303	184,871	△184,871	—
計	13,898,532	3,467,903	17,366,435	3,344,537	20,710,973	△184,871	20,526,102
セグメント利益	736,952	883,620	1,620,573	282,210	1,902,783	△342,280	1,560,502

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△342,280千円には、セグメント間取引の消去328,281千円、各報告セグメントに配分していない全社費用13,999千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「その他」セグメントにおいて1,094,138千円の減損損失を計上しております。